

2007年11月2日

京セラ株式会社 中間決算説明会

代表取締役社長
川村 誠

京セラ株式会社

本日のプレゼンテーション

2008年3月期 中間期 決算概要

2008年3月期 通期業績予想

将来予想に関する注意事項

この配布資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。かかるリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 当社が関連する市場の状況(特に、日本、米国、欧州及びアジア(中国を含む)の経済状況)。
- (2) 中国における経済・政治・法律面での条件の予測し得ない変化。
- (3) 競争の厳しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場における当社の、革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて、顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力。
- (4) 生産高や業績に影響を与える社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。
- (5) 円高、政治的・経済的な不安定状態、輸出売掛金の回収の困難性、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業所管理の問題、知的財産権の保護の不十分性等輸出に影響する可能性がある要素。
- (6) 当社の売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)と円との為替レート。
- (7) 技術力を有する科学・技術その他の分野の人材の不足。
- (8) 当社の機密保持及び特許等の知的財産権の保護の確保。
- (9) 当社製品を継続的に製造・販売する為に必要となるライセンスの安定的確保。
- (10) 生産及び開発能力の拡大、もしくは現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない場合。
- (11) テロ行為、疾病の発生、その他当社の市場やサプライチェーンに混乱を与える可能性のある要素。
- (12) 当社の製造施設その他主要な事業関連施設がある地域における地震などの自然災害の発生。
- (13) 保有する有価証券その他の資産の時価の変動、減損処理の発生及び会計基準の変更。

かかるリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開または財務状況は、これらの将来予想に関する記述に明示または包含される将来の業績、事業活動、展開または財務状況と大きく異なる場合があります。当社は、この配布資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

2008年3月期 中間期 連結決算概要

(単位:百万円)

	2007年3月期 中間期		2008年3月期 中間期		前年同期比 増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
売上高	615,390	100.0	636,560	100.0	3.4
営業利益	63,128	10.3	67,823	10.7	7.4
税引前中間純利益	72,385	11.8	81,480	12.8	12.6
中間純利益	53,493	8.7	50,620	8.0	-5.4
希薄化後1株当たり 中間純利益(円)	284.14	—	267.06	—	-6.0
設備投資額	37,239	6.1	32,592	5.1	-12.5
減価償却費	33,682	5.5	37,291	5.9	10.7
研究開発費	30,257	4.9	31,060	4.9	2.7
平均為替レート	対ドル: 115円	対ユーロ: 146円	対ドル: 119円	対ユーロ: 162円	
為替の変動による 影響額(前年同期比)	売上高	218億円	226億円		
	税引前 中間純利益	82億円	89億円		

2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト（1）

1. 当中間期の売上高は過去最高

2. 第2四半期の売上高、営業利益は第1四半期を上回る

3. 減価償却費は大幅に増加したが、営業利益は前年同期に比べ増益となる

- ・ 減価償却費の計上方法見直しによる影響額は75億円
- ・ 第2四半期に耐用年数経過の建物関連設備について、35億円を一括計上

4. 4期連続で増配を予定

2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト（2）

－ 事業別業績 －

（単位：百万円）

		2008年3月期		増減額	増減率
		第1四半期	第2四半期		
部品事業	売上高	162,695	170,441	7,746	4.8%
	事業利益	23,456	25,485	2,029	8.7%
	事業利益率	14.4%	15.0%	—	—
機器事業	売上高	127,231	123,585	-3,646	-2.9%
	事業利益	9,037	10,079	1,042	11.5%
	事業利益率	7.1%	8.2%	—	—
その他の事業	売上高	31,628	33,649	2,021	6.4%
	事業利益	1,297	2,667	1,370	2.1倍
	事業利益率	4.1%	7.9%	—	—

2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト（3）

1. 当中間期の売上高は過去最高

2. 第2四半期の売上高、営業利益は第1四半期を上回る

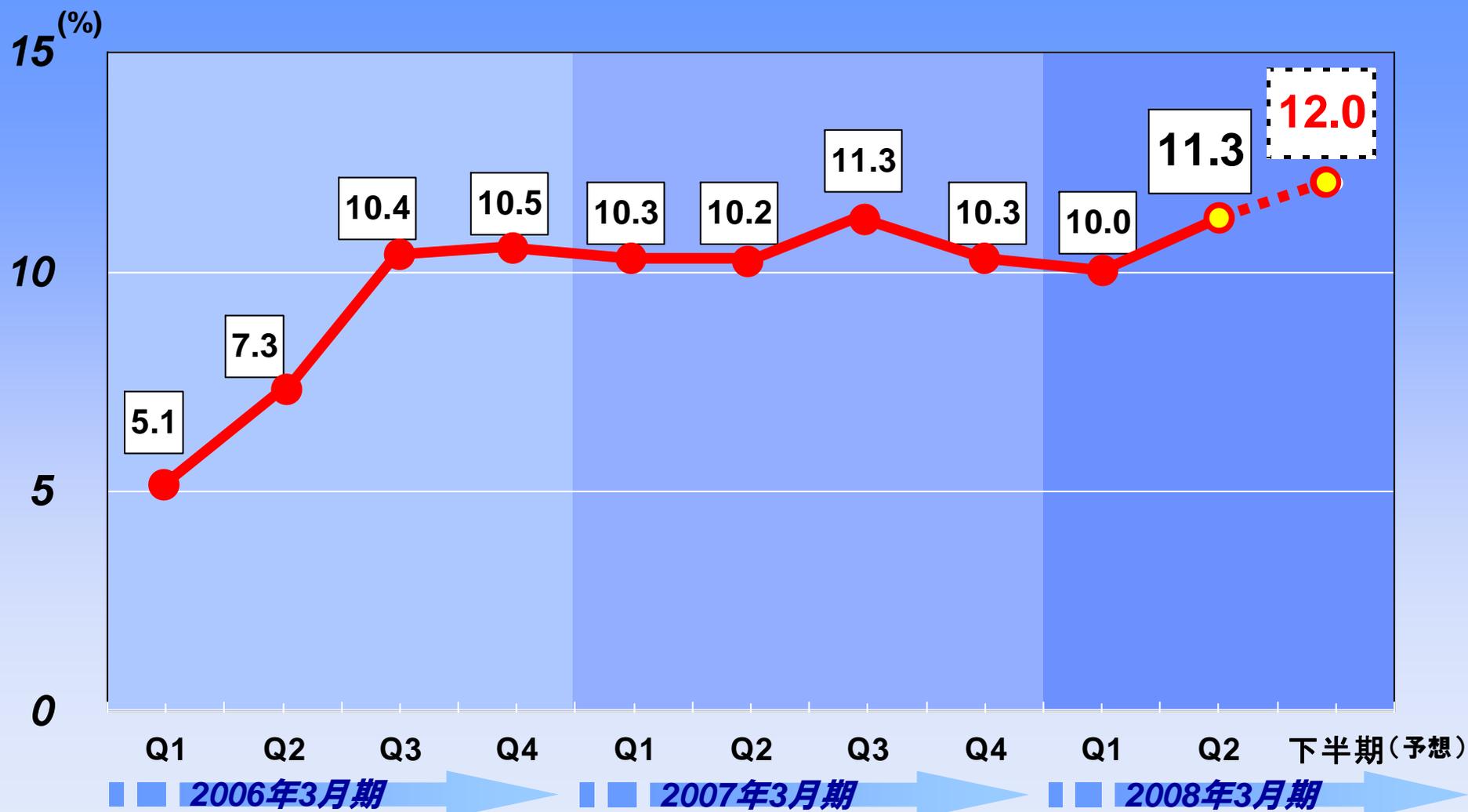
3. 減価償却費は大幅に増加したが、営業利益は前年同期に比べ増益となる

- ・ 減価償却費の計上方法見直しによる影響額は75億円
- ・ 第2四半期に耐用年数経過の建物関連設備について、35億円を一括計上

4. 4期連続で増配を予定

2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト (4)

－ 四半期別 営業利益率の推移 －



2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト（5）

1. 当中間期の売上高は過去最高

2. 第2四半期の売上高、営業利益は第1四半期を上回る

3. 減価償却費は大幅に増加したが、営業利益は前年同期に比べ増益となる

- ・ 減価償却費の計上方法見直しによる影響額は75億円
- ・ 第2四半期に耐用年数経過の建物関連設備について、35億円を一括計上

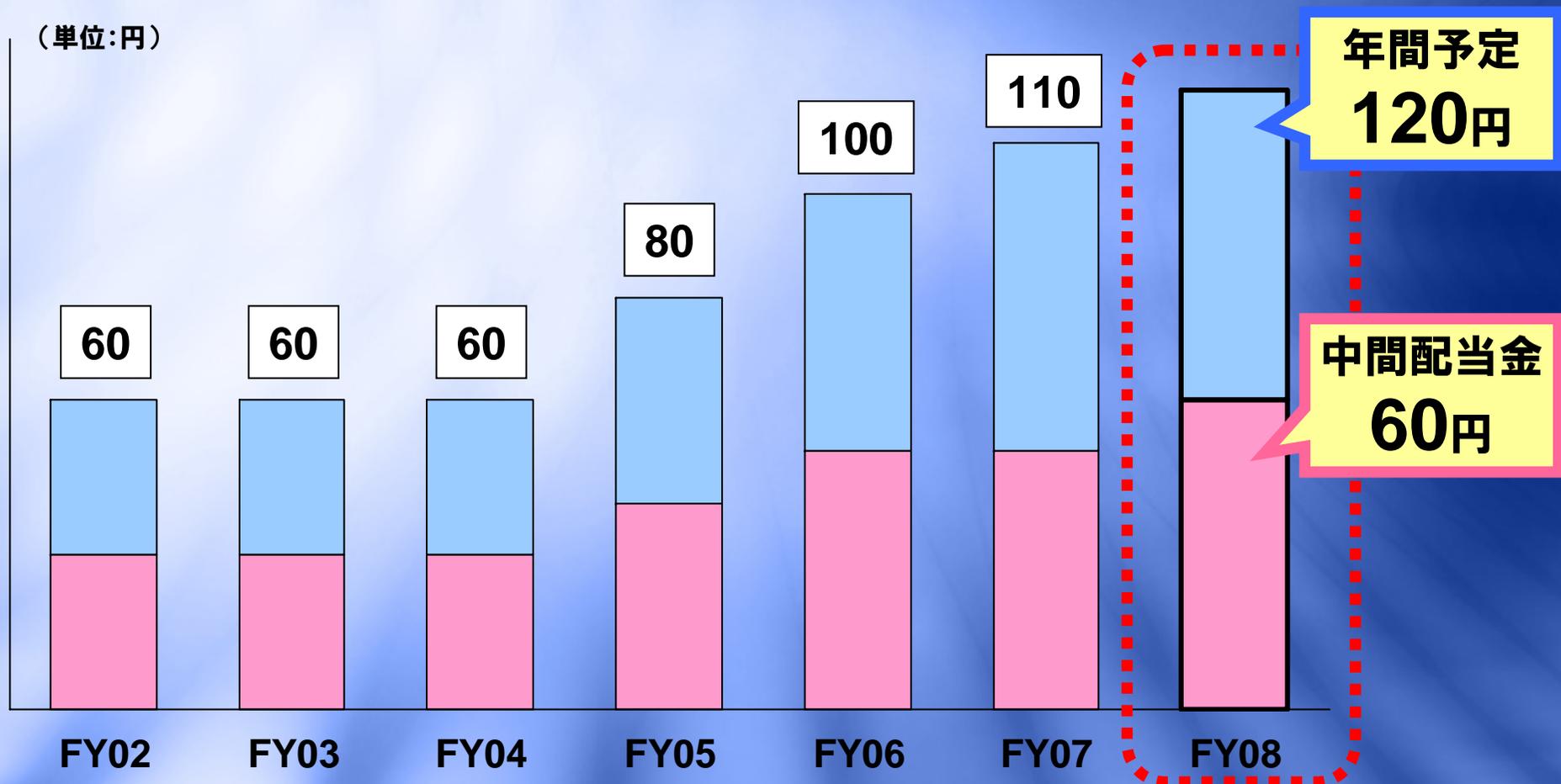
4. 4期連続で増配を予定

2008年3月期 中間期 連結決算ハイライト（6）

－ 1株当たり配当金の推移 －

2008年3月期の年間配当金は120円を予定

（単位：円）



本日のプレゼンテーション

2008年3月期 中間期 決算概要

2008年3月期 通期業績予想

2008年3月期 事業環境見通し

(当社予想)

世界の主要電子機器の生産台数見通し

	CY2006 (百万台)	CY2007見通し (CY06比増減率)	需要拡大の背景
携帯電話端末	980	+10%	<ul style="list-style-type: none"> 新興市場での需要増加 欧米での高機能端末への買替え需要拡大
パーソナルコンピュータ	230	+10%	<ul style="list-style-type: none"> ノートパソコン、新OSの需要増加 新興市場での需要増加
デジタルテレビ	60	+50~60%	<ul style="list-style-type: none"> 薄型大型テレビの需要増加

部品単価の動向

(例:セラミックコンデンサ(汎用品)) 年間で前期末比10%前後の下落にとどまる

2008年3月期 連結業績予想（1）

（単位：百万円）

	2007年3月期		2008年3月期 予想		前期比 増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
売上高	1,283,897	100.0	1,330,000	100.0	3.6
営業利益	135,102	10.5	151,000	11.4	11.8
税引前当期純利益	156,540	12.2	166,000	12.5	6.0
当期純利益	106,504	8.3	103,000	7.7	-3.3
希薄化後1株当たり 当期純利益（円）	564.79	—	543.40	—	-3.8
設備投資額	69,896	5.4	81,000	6.1	15.9
減価償却費	70,155	5.5	79,000	5.9	12.6
研究開発費	61,100	4.8	65,000	4.9	6.4

平均為替レート	対ドル: 117円	対ユーロ: 150円
為替の変動による 影響額(前期比)	売上高	396億円
	税引前 当期純利益	157億円

		中間期実績	下半期予想
平均為替 レート	対ドル	119円	110円
	対ユーロ	162円	150円
為替変動に よる影響額 (前期比)	売上高	226億円	-264億円
	税引前 当期純利益	89億円	-64億円

2008年3月期 連結業績予想（2）

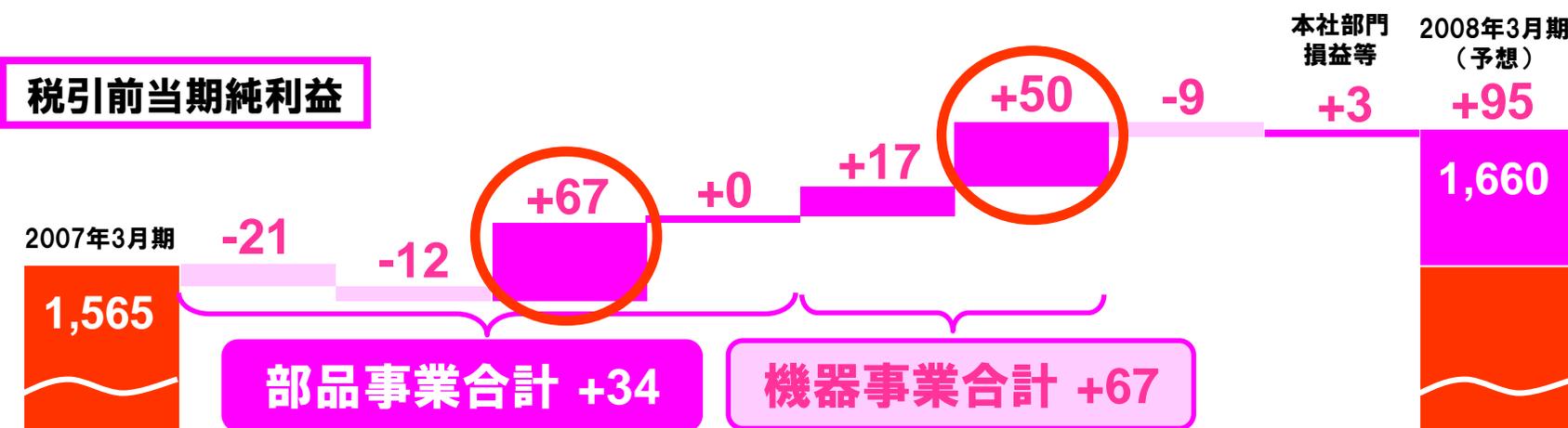
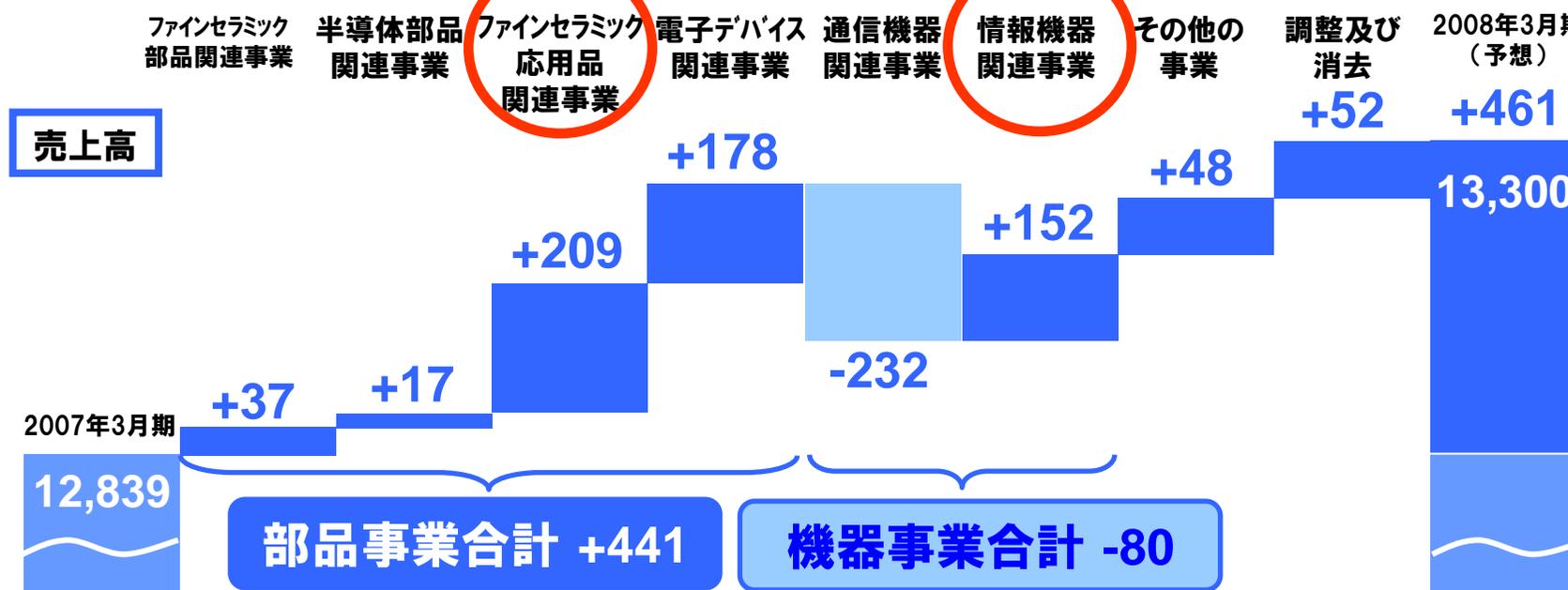
（単位：百万円）

		2007年3月期	2008年3月期予想	増減率
部品事業	売上高	650,877	695,000	6.8%
	事業利益	104,708	108,000	3.1%
	事業利益率	16.1%	15.5%	—
機器事業	売上高	519,964	512,000	-1.5%
	事業利益	34,261	41,000	19.7%
	事業利益率	6.6%	8.0%	—
その他の事業	売上高	137,235	142,000	3.5%
	事業利益	6,881	6,000	-12.8%
	事業利益率	5.0%	4.2%	—

2008年3月期 事業セグメント別売上高・税引前当期純利益予想

— 前期比増減額 —

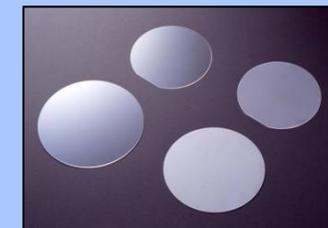
(単位:億円)



下半期以降の取組み（1）

ファインセラミック部品

- ◆ 携帯電話の世界的拡大継続により、LED用サファイア基板、基地局用誘電体セラミック部品の売上拡大
- ◆ 継続的な事業拡大を図る取組みを進める



LED用サファイア基板

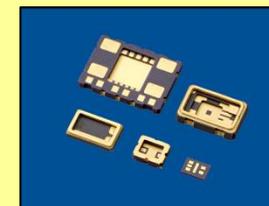
半導体部品

セラミックパッケージ

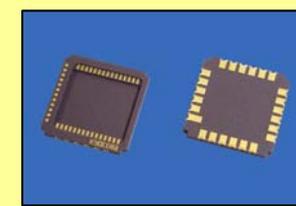
- ◆ 携帯電話端末用パッケージの売上拡大
- ◆ 新市場開拓

有機パッケージ

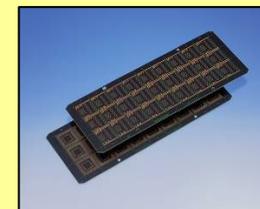
- ◆ 携帯電話端末向けSiP基板の売上拡大
- ◆ ASIC用パッケージの売上拡大



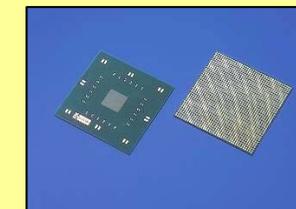
電子部品用表面実装 (SMD) パッケージ



CCD/CMOS用パッケージ



SiP基板



ASICパッケージ

下半期以降の取組み（2）

ファインセラミック応用品 –ソーラーエネルギー事業–

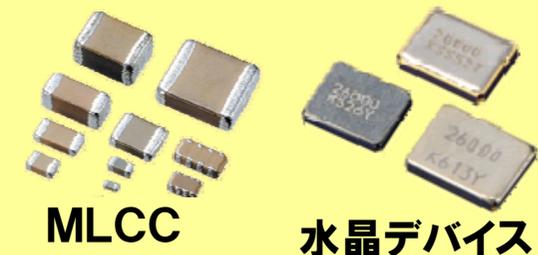
- ◆ 下半期にソーラー・モジュールの生産量を上半期比約25%拡大
- ◆ 下半期の国内市場は、産業用途の大型案件増加
- ◆ FY11に500MWまでの生産拡大を計画
- ◆ 変換効率アップへの取組み強化
バックコンタクト、セルの表面処理技術の開発継続



ソーラー発電施設
(スペイン)

電子デバイス

- ◆ 第3四半期の好調な需要に増産効果が寄与し、売上拡大
(セラミックコンデンサ、水晶振動子、SAWフィルタ)
- ◆ 重要市場の攻略
(デジタル家電／多様な無線アプリケーション／高速半導体周辺)
- ◆ 新製品の開発強化(新製品比率のアップ)
- ◆ 機器部門との連携強化



MLCC

水晶デバイス

下半期以降の取組み（3）

通信機器

- ◆ 新WIN端末投入による国内携帯電話事業の売上拡大
- ◆ KWCの下半期黒字化
- ◆ 国内PHS端末事業強化



KPC680
EV-DO Rev.A対応
下り3.1Mbps



W53K
薄さ15.4mm
ワンセグ受信

情報機器

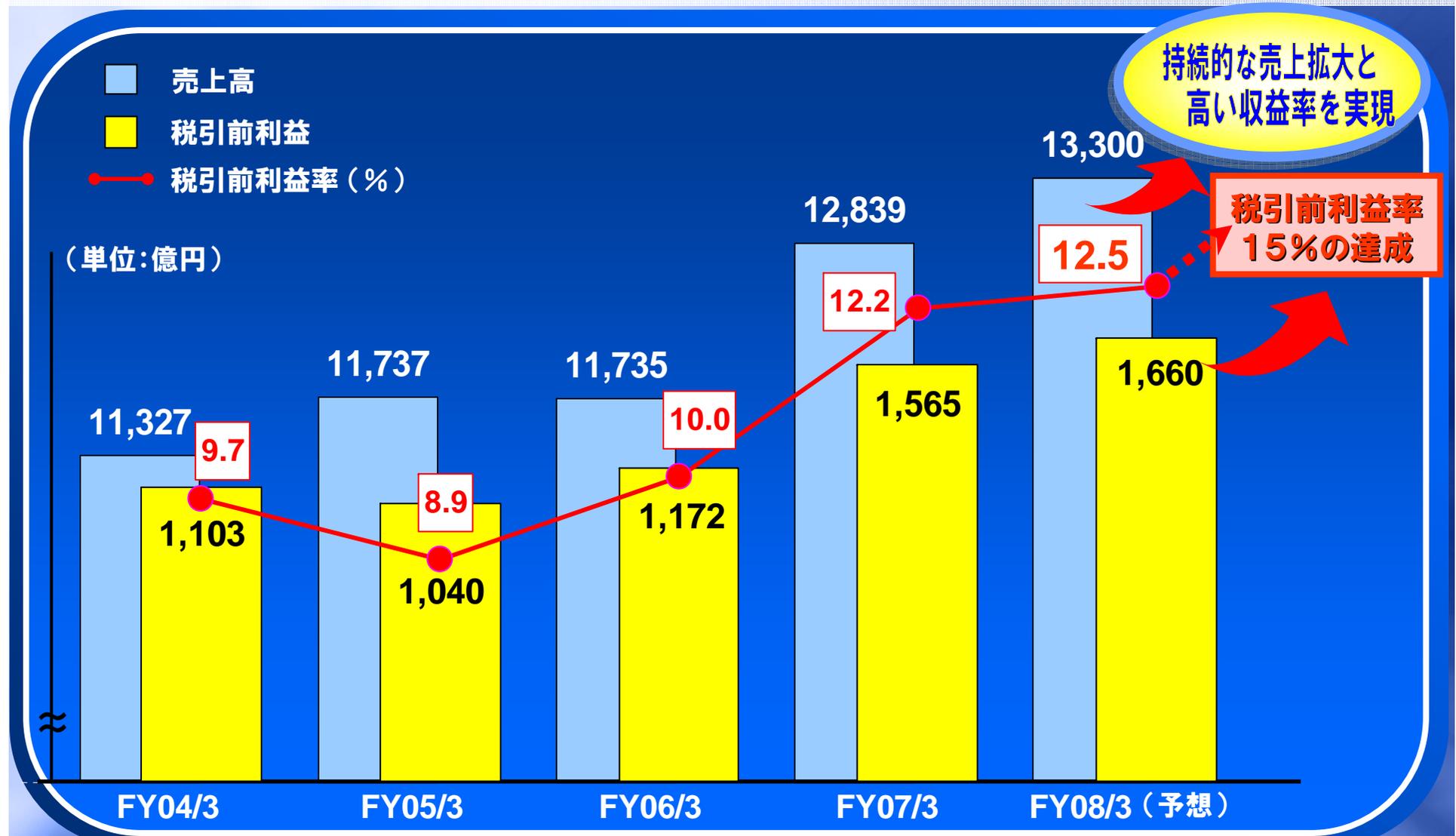
- ◆ 継続的なカラープリンタ、カラーMFPの新製品の市場投入
- ◆ トナー工場の新設によるカラー消耗品の競争力強化
- ◆ 東欧、BRICs諸国でのモノクロ機販売強化
- ◆ 欧州物流センターへの物流統合による顧客満足度の向上



カラーMFP
KM-C4035E

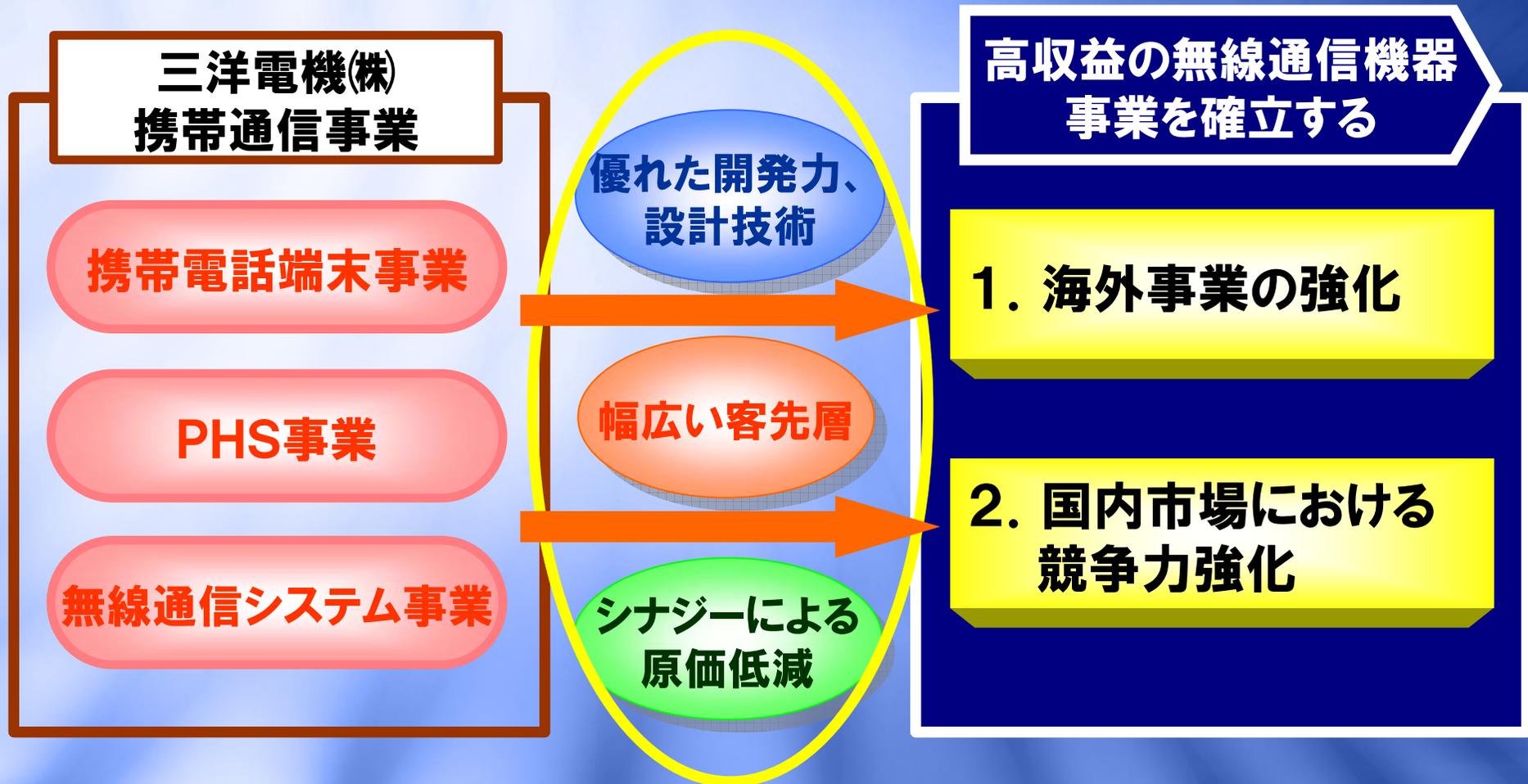
連結売上高・税引前利益の推移

— 2004年3月期～2008年3月期(予想) —



通信機器関連事業の強化

京セラグループのコア事業を強化する



2008年3月期 事業セグメント別連結売上高予想

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2007年3月期		2008年3月期				前期比 増減率(%)
			前回予想 (2007年4月)		今回予想 (2007年10月)		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
■ ファインセラミック部品関連事業	81,326	6.3	85,000	6.4	85,000	6.4	4.5
■ 半導体部品関連事業	152,292	11.9	157,000	11.8	154,000	11.6	1.1
■ ファインセラミック応用品関連事業	131,103	10.2	144,000	10.8	152,000	11.4	15.9
■ 電子デバイス関連事業	286,156	22.3	290,000	21.8	304,000	22.9	6.2
部品事業 計	650,877	50.7	676,000	50.8	695,000	52.3	6.8
■ 通信機器関連事業	251,183	19.6	265,000	19.9	228,000	17.1	-9.2
■ 情報機器関連事業	268,781	20.9	274,000	20.6	284,000	21.4	5.7
機器事業 計	519,964	40.5	539,000	40.5	512,000	38.5	-1.5
■ その他の事業	137,235	10.7	140,000	10.5	142,000	10.7	3.5
調整及び消去	-24,179	-1.9	-25,000	-1.8	-19,000	-1.5	—
売上高	1,283,897	100.0	1,330,000	100.0	1,330,000	100.0	3.6

2008年3月期 事業セグメント別連結事業利益予想

(単位:百万円)

■ 事業セグメント	2007年3月期		2008年3月期				前期比 増減率(%)
			前回予想 (2007年4月)		今回予想 (2007年10月)		
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	
■ ファインセラミック部品関連事業	15,677	19.3	16,000	18.8	13,500	15.9	-13.9
■ 半導体部品関連事業	22,210	14.6	24,000	15.3	21,000	13.6	-5.4
■ ファインセラミック応用品関連事業	22,334	17.0	27,000	18.8	29,000	19.1	29.8
■ 電子デバイス関連事業	44,487	15.5	46,000	15.9	44,500	14.6	0.0
部品事業 計	104,708	16.1	113,000	16.7	108,000	15.5	3.1
■ 通信機器関連事業	291	0.1	6,000	2.3	2,000	0.9	587.3
■ 情報機器関連事業	33,970	12.6	35,000	12.8	39,000	13.7	14.8
機器事業 計	34,261	6.6	41,000	7.6	41,000	8.0	19.7
■ その他の事業	6,881	5.0	7,000	5.0	6,000	4.2	-12.8
事業利益 計	145,850	11.4	161,000	12.1	155,000	11.7	6.3
本社部門損益等	10,690	—	5,000	—	11,000	—	2.9
税引前当期純利益	156,540	12.2	166,000	12.5	166,000	12.5	6.0

当該資料に関する注意事項

2007年3月期に、ファイナンス事業を行う当社子会社であった京セラリーシング（株）を売却したことにより、京セラリーシング（株）に関わる営業成績及び売却益の合計額を、米国会計基準に従い、非継続事業の損益としています。この売却に伴い、2003年3月期から2006年3月期までの実績値についても同様の基準で一部組み替えて表示しています。

THE NEW VALUE FRONTIER



京セラ株式会社